



## ANEXO CONVOCATORIA

1017/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Procesador Intel Core i7 11700 de 11ava generacion 8 núcleos, 16 hilos/subprocesos, de 4.90 Ghz o superior. Motherboard H510 (o superior) con: - Salidas para monitores HDMI y VGA (* En configuraciones con mother H510.) o HDMI- HD Audio integrado, 4 slots para memoria RAM DDR4 o superior. - Conexion Red LAN (por cable) integrada de 1gbps o superior. - 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A - 4 puertos USB 2.0 - Disco rigido HDD de 2Tb + Disco solido SSD de 480Gb - Video Graficos Integrados Intel UHD630 con resolucion 4K - Memoria RAM 64GB (2x32) - Fuente 800W - Gabinete Rackeable compatible con racks de 19'' 2U-550
2	Doble Extrusor Dual Drive Con sistema de filamento abierto (EXTRUSIÓN DIRECTA) Volumen de impresión 300mm (Ancho) X 300mm (Profundidad) X 350mm (Alto) Material soportado PLA, ABS, Flex, Wood, Nylon, Etc Temperatura máxima de extrusor 260º C Temperatura máxima de plataforma 90º C
3	- Procesador intel i5 onceava generación o superior - 8gb ram o superior - disco nvme 240gb o superior - Display 14 o 15 pulgadas con resolucion 1920x1080 (FullHD) o superior - Teclado distribucion US
4	Capacidad: 8 TB Interfaces: SATA III Velocidad de rotación: 7200 rpm Tecnología de almacenamiento: NAS Aplicaciones: RAID, NAS Factor de forma: 3.5 " Caché de datos: 256MB TAMAÑO: Ancho: 101.6 mm / Altura: 26.1 mm / Profundidad: 147 mm PESO: 0.715 gr
5	Tapizado abastonado, estructura fabricada en acero cromado, base en aluminio pulido.

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras